

5G社会に貢献する

 **メック株式会社**

2023年3月25日（土）



2022年12月期 概況

事業環境

個人消費の停滞により、パソコンやスマートフォン、ディスプレイ、タブレットPC等、コンシューマー向け電子機器需要は低調に推移。堅調であったデータセンターも在庫循環的な調整局面入りとなった。

決算概況

前期比 増収増益

PKG基板向けに強みを持つ「CZシリーズ」が売上拡大に寄与。為替が円安に振れたことも影響し、増収増益となった。

主要製品概況

CZ : 半導体市況の影響を受けたものの、PKG基板の大型・高多層化により堅調に推移し、売上拡大に寄与。

V-Bond : 自動車やスマートフォンの減産によりほぼ横ばい。

EXE : 消費マインドの冷え込みや在庫調整等の影響を受け大きく減少。

SF : 消費マインドの冷え込みや在庫調整等の影響を受け大きく減少。

2022年12月期 業績概要

(単位：百万円)

項目	FY2021 (実績)	FY2022		
		(実績)	前期比	
売上高	15,038	16,329	1,290	8.6%
薬品売上高	14,756	16,042	1,285	8.7%
営業利益	3,939	4,004	64	1.6%
営業利益率	26.2%	24.5%	-1.7ppt	-
経常利益	4,104	4,246	142	3.5%
経常利益率	27.3%	26.0%	-1.3ppt	-
当期純利益	2,949	3,064	115	3.9%
1株当たり当期利益 (円)	155.28	161.22	-	-

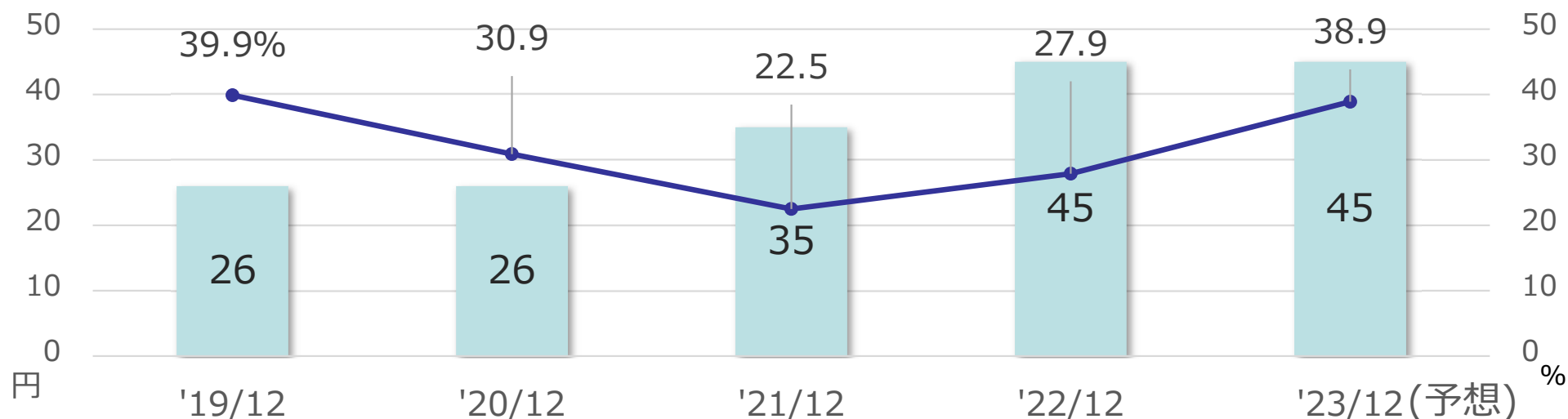
2023年12月期 連結業績予想

項目	FY2023					
	1H			Full-year		
	百万円	利益率 (%)	増減率	百万円	利益率 (%)	増減率
売上高	6,500	-	20.0%減	15,000	-	8.1%減
営業利益	800	12.3	61.6%減	3,000	20.0	25.1%減
経常利益	850	13.1	64.2%減	3,100	20.7	27.0%減
純利益	600	9.2	63.9%減	2,200	14.7	28.2%減
1株当たり 純利益 (円)	31.56	-	-	115.72	-	-

株式と株主還元

配当金推移

※中期的目標は連結配当性向30%



自己株式の取得

- 2018年12月 200,000株
- 2017年3月 200,000株
- 2016年3月 140,000株
- 2015年11月 500,000株
- 2009年2月 300,000株

株主優待

- 100株以上 QUOカード1,000円
 - 1,000株以上 QUOカード2,000円
- ※毎年12月31日現在の株主名簿に記載または記録された当社株式100株（1単元）以上保有の株主様が対象

会社概要

(2022年12月31日現在)

社名	メック株式会社 MEC COMPANY LTD.
本社所在地	兵庫県尼崎市杭瀬南新町3丁目4番1号
設立年月日	1969（昭和44）年5月1日
主な業務内容	電子基板・部品製造用薬品の開発・製造販売 及び 機械装置、各種資材の販売
代表者	代表取締役社長 前田 和夫
資本金	5億9,414万2,400円
連結売上高	163億29百万円
上場市場	東証プライム市場（4971／化学セクター）
従業員数	連結438名、単体253名

株主構成（所有株式数）

	2021.6	%	2021.12	%	2022.6	%	2022.12	%
個人	5,484,409	27.3	5,494,092	27.3	5,705,803	28.4	7,411,266	36.9
金融機関	6,703,870	33.4	6,844,470	34.1	7,028,129	35.0	6,052,129	30.2
国内法人	1,601,740	8.0	1,598,901	8.0	1,625,306	8.1	1,642,663	8.2
外国人	4,635,568	23.1	4,858,788	24.2	4,163,540	20.7	3,736,113	18.6
証券会社	749,787	3.7	379,069	1.9	652,542	3.3	333,107	1.7

仕事を楽しむ

『 独創の技術 』

『 信頼の品質 』

『 万全のサービス 』

わたしたちは

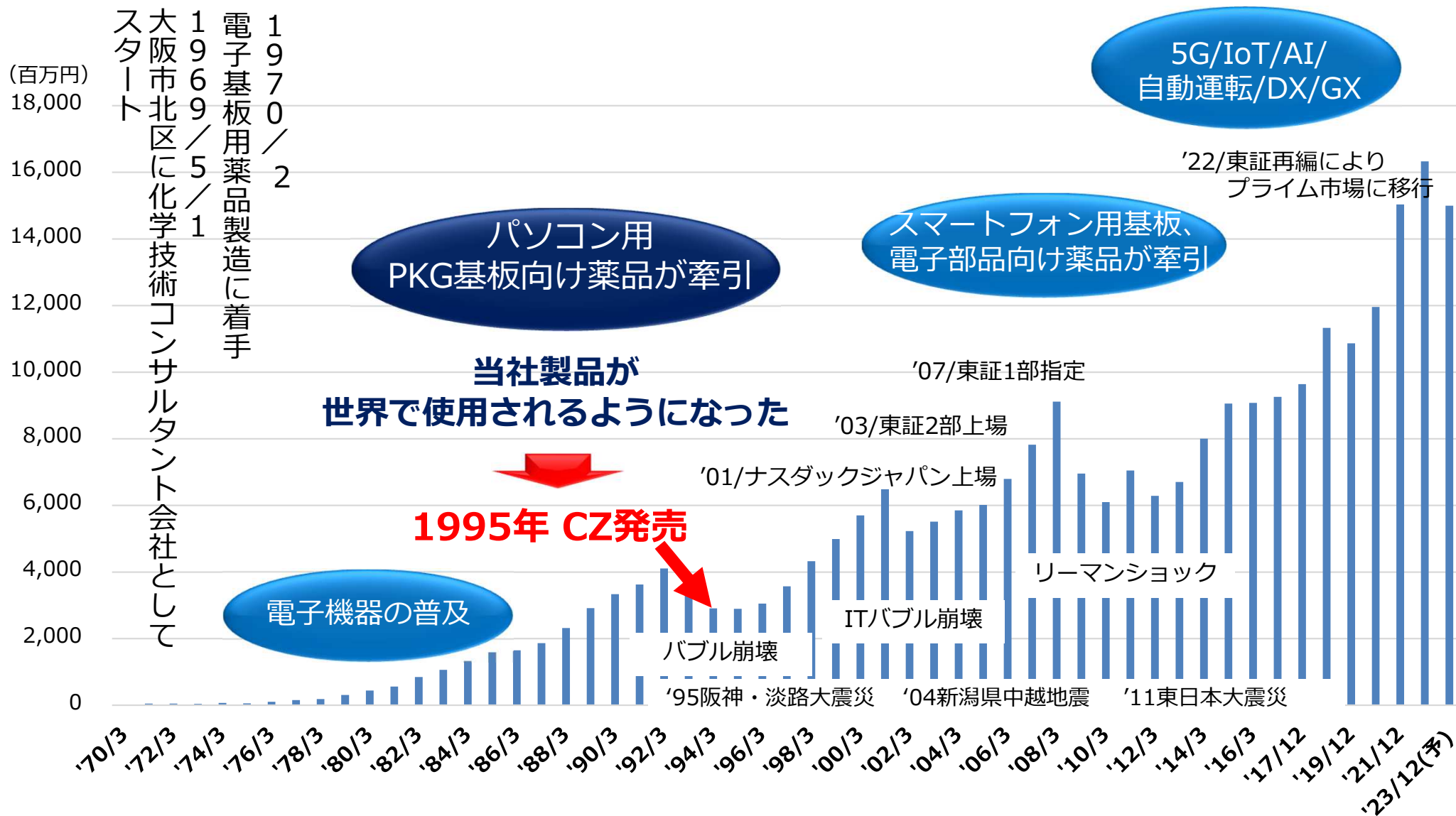
「独創の技術」「信頼の品質」「万全のサービス」を信条に、自由に着想し、グローバルな事業活動を通して界面価値創造を実現することで豊かで潤いのある社会と環境づくりに貢献します。

メックは...

電子基板・部品製造時に使用される
“**薬品**を開発・製造・販売”
金属を溶かし表面に付加価値を与える

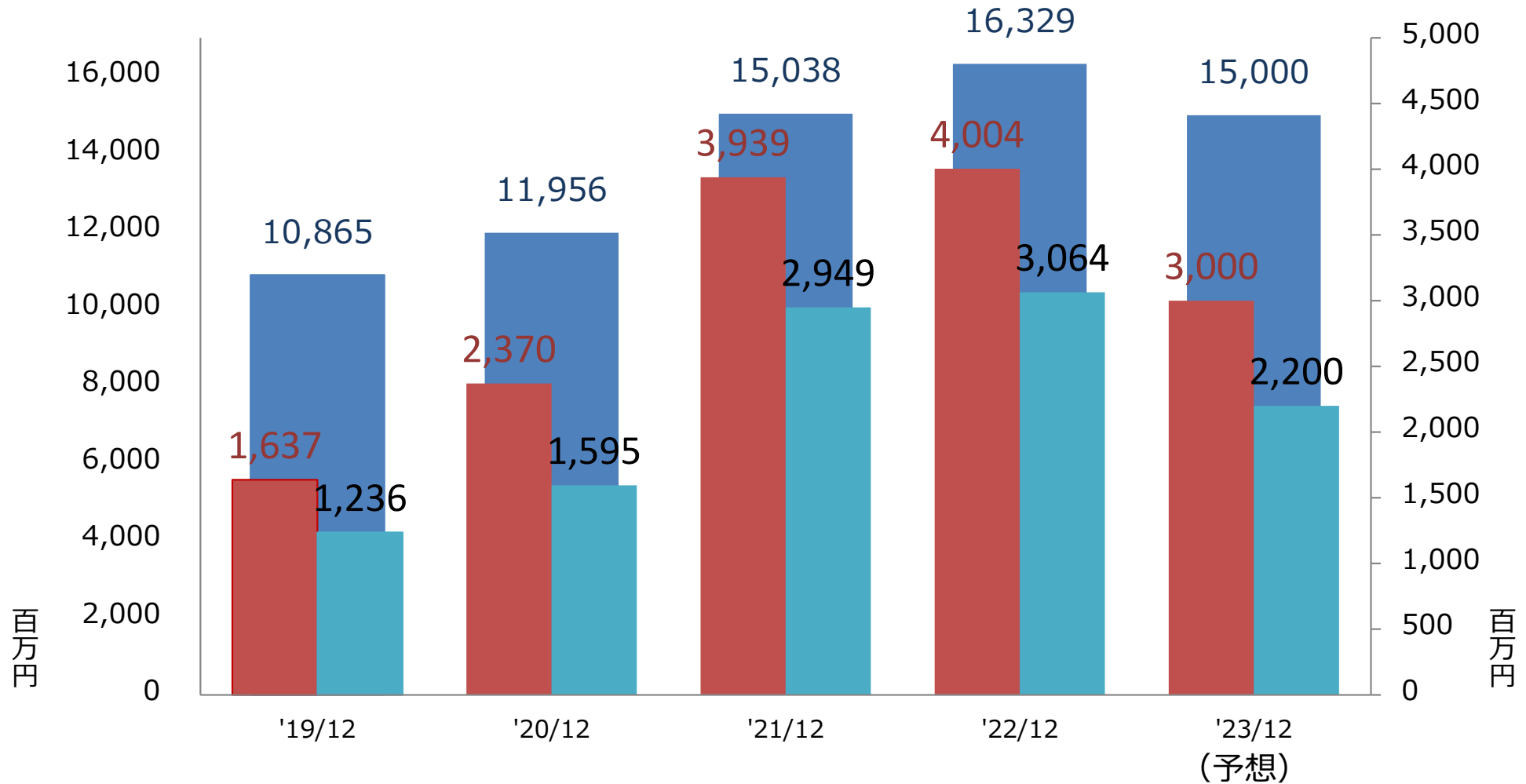
- ・基板メーカーではありません
- ・「めっき」はしていません
- ・連結売上高の約10%を研究開発に投資
- ・研究開発人員は単体従業員の三分の一
- ・半導体を搭載するパッケージ基板で「CZシリーズ」が銅表面処理剤として**独占的**なシェアを獲得

創業からの売上推移



連結通期業績推移

■ 売上高 ■ 営業利益 ■ 純利益



メック国内拠点



本社・尼崎事業所

2017年

「本社機能」「研究開発」「製造」
の3拠点を集約

本社・尼崎事業所
(兵庫/尼崎市)

長岡工場1993年



工場(新潟/長岡市)

営業所(東京/立川市) 1974年

東初島研究所 1989年/2020年

2017年

「本社・尼崎事業所」集約により閉鎖
2020年

研究開発拡充のため「東初島研究所」
として再スタート



メック海外拠点



メック製品の流れ

MMEC



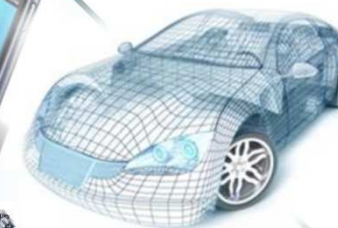
研究開発から**配合表**



MEC工場で製品を生産



基板メーカー
部品メーカー



販売店から
皆さまのもとに

MMEC

メックが活躍できる分野

インターネットや移動通信のインフラ

モビリティ



サーバー



基地局・Mobile Edge Computing

遠隔医療



スマートフォン



P C

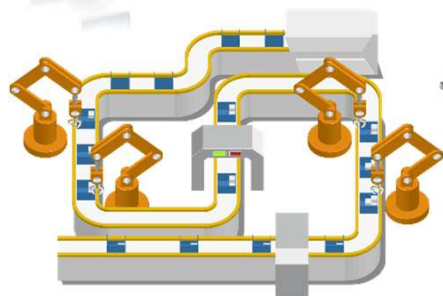
さまざまな用途向けの
電子基板・部品に使われる
メックの製品

タブレットP C

ウェアラブル



ロボット



フラットパネルディスプレイ



スパコン



メックが成長するキーワード

5G

- 通信方法の世代

IoT・AI

- あらゆるものがネットでつながり情報処理に人工知能を応用

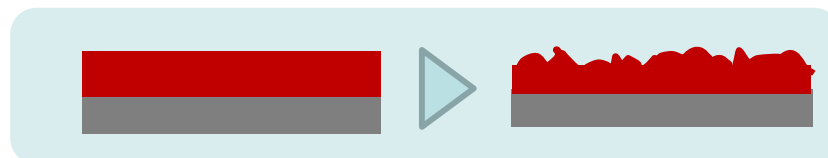
くるま

- 運転アシストシステム
- 電気自動車

界面価値創造

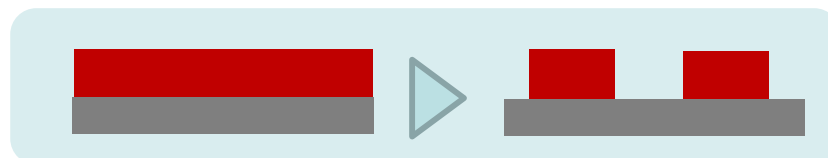
- 表面を粗化し、
機械的に密着性を向上

CZ、V-Bond



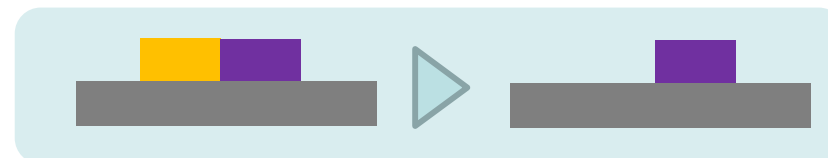
- 配線を形成する

EXE

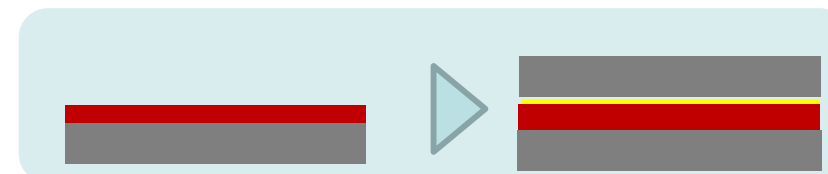


- 選択エッチング

SF



- 表面を処理し、
化学的に密着性を向上



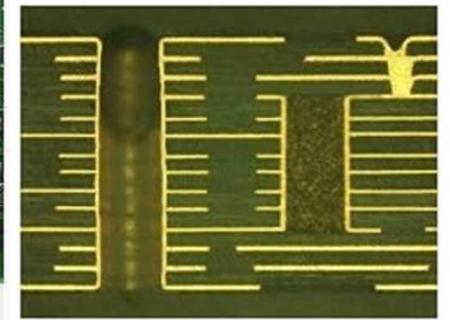
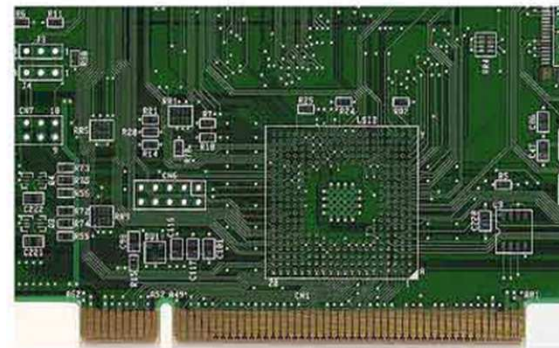
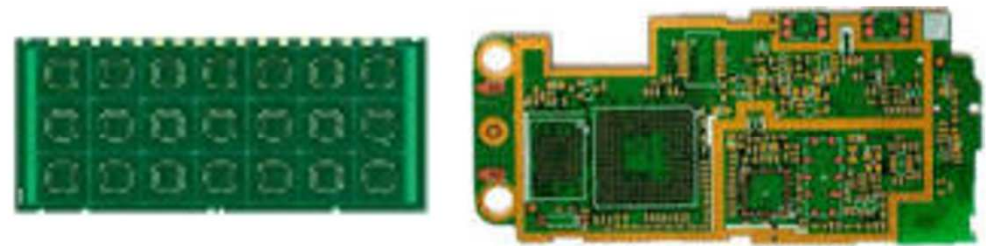
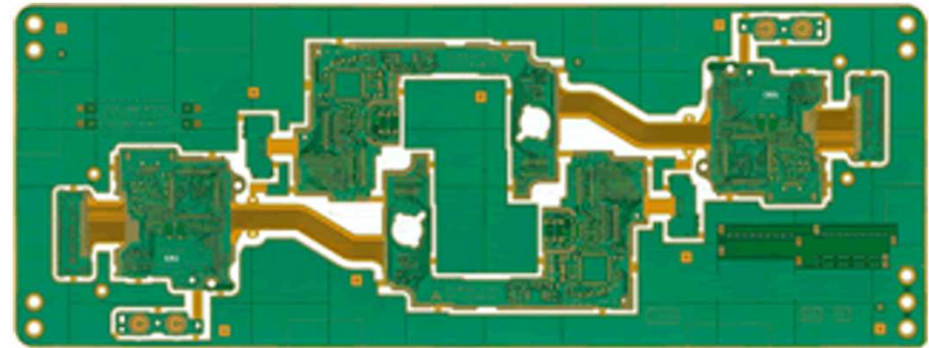
主要薬品用途と最終製品例

主要薬品	特徴	最終製品例
超粗化系密着向上剤 「CZシリーズ」	主にPKG基板向けの密着向上剤。 銅と樹脂との密着性を高める銅表面処理剤。	5G関連・データセンター等のインフラ、パソコン・スマートフォン・タブレットPC等の高機能デバイス等
多層電子基板向け密着向上剤 「V-Bondシリーズ」	多層基板向けの密着向上剤。 銅と樹脂との密着性を高める銅表面処理剤。PKGには使用されない。	スマートフォン・クルマ等
異方性エッチング 「EXEシリーズ」	COF基板向けのエッチング剤。 サブトラで微細配線形成ができる。	テレビ・パソコンのモニター等
選択エッチング銅除去剤 「SFシリーズ」	銅への選択性を持ったエッチング剤。	タブレットPC等

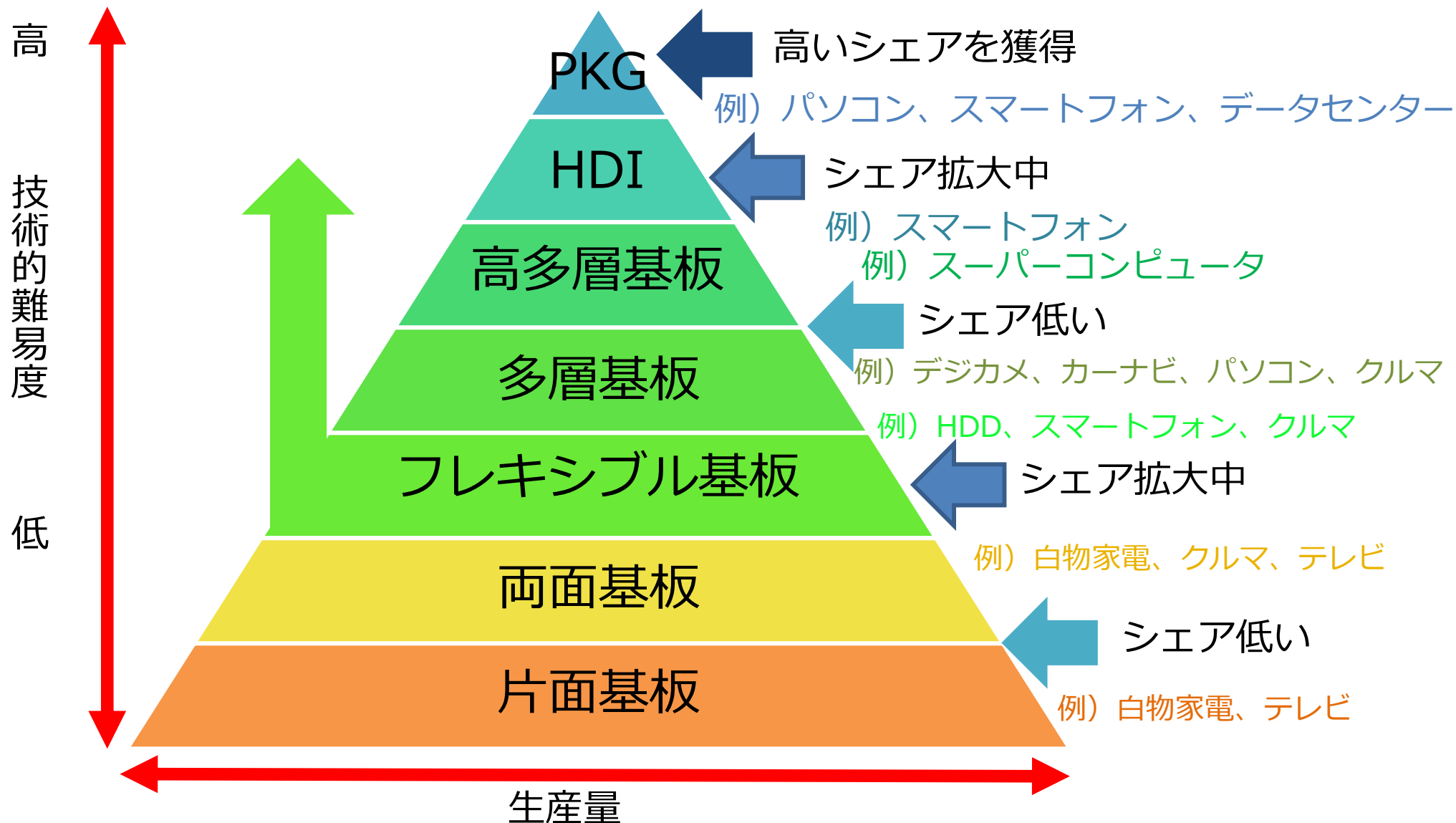
電子基板とは

電子基板は、
家電、通信機器、医療機器
から飛行機や自動車、
産業機器まであらゆる分野で
使用されています。

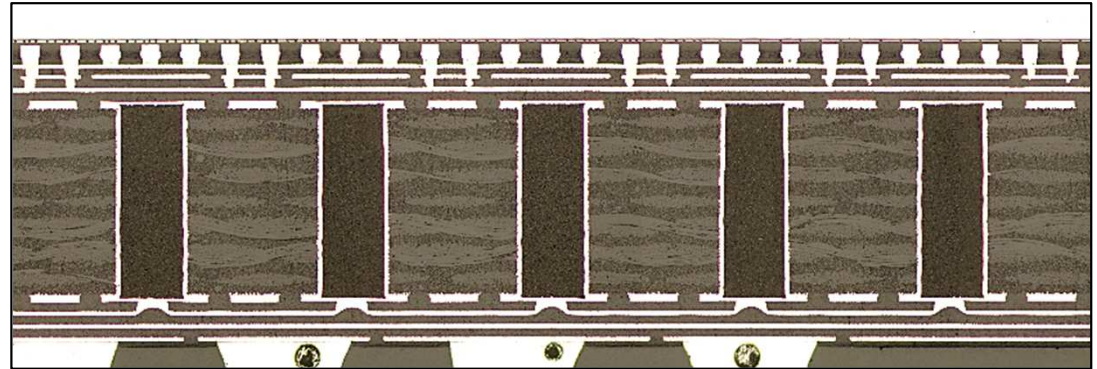
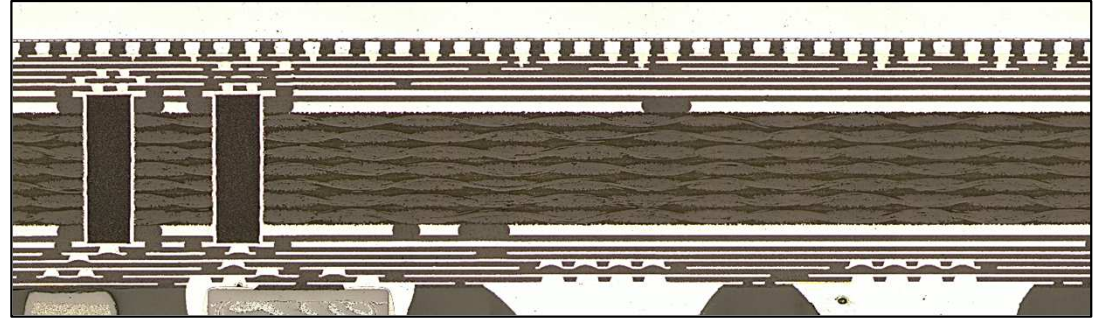
メックは、
私達の暮らしに欠かせない
電子基板の製造の過程で
使用する薬品・機械を開発し、
皆様にお届けしています。



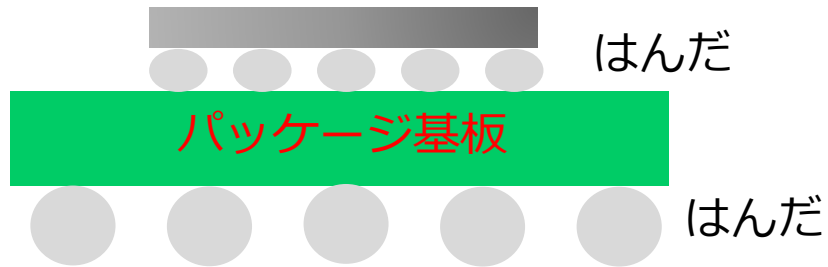
メックが強い領域



パッケージ基板



半導体

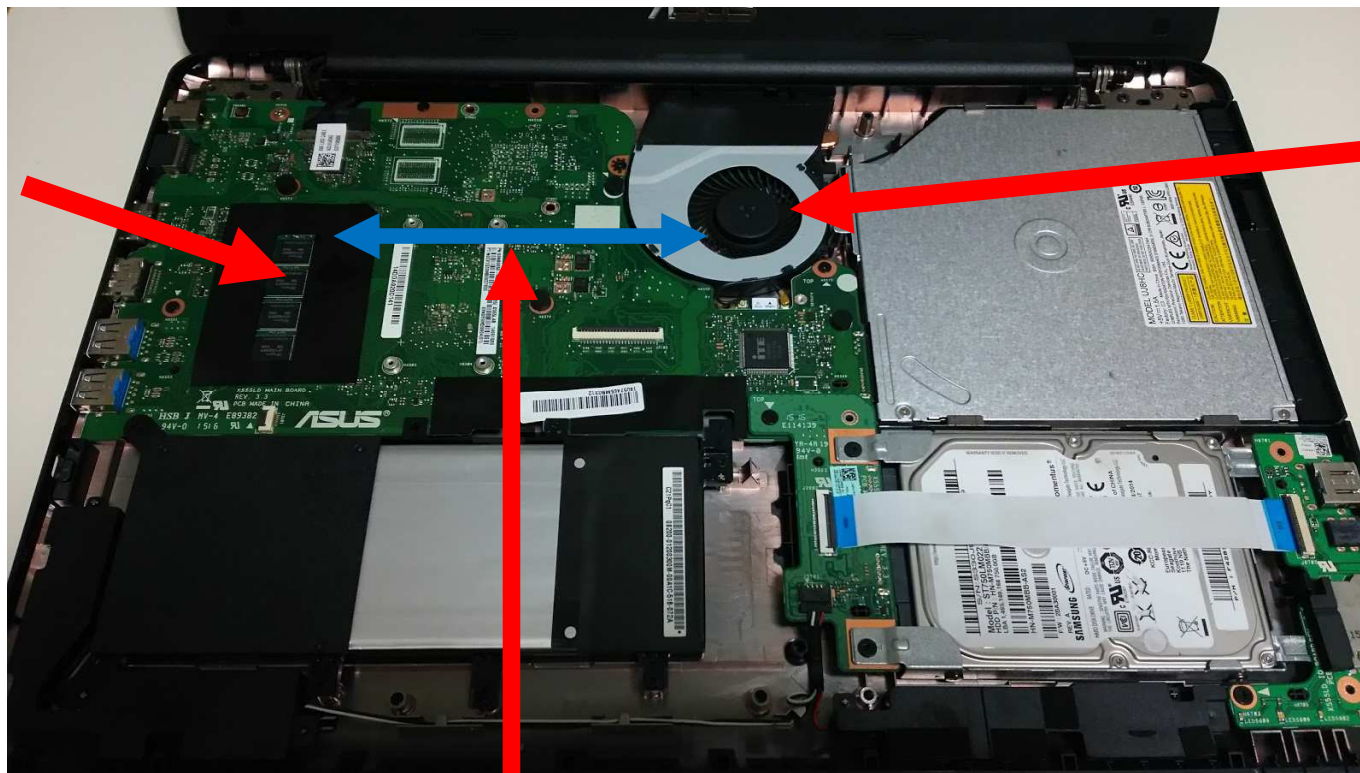


半導体は **nm**ルール
電子基板は **μm**ルール
 $1\text{mm} = 1,000\mu\text{m}$
 $1\text{mm} = 1,000,000\text{nm}$

半導体PKG基板の断面イメージ

コンピューターの中身

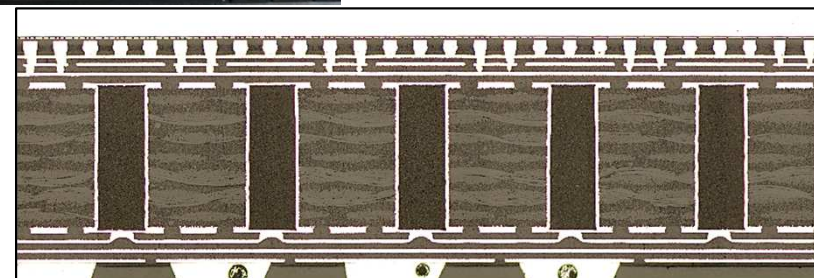
メモリ



冷却ファン下に
CPUを搭載した
PKG

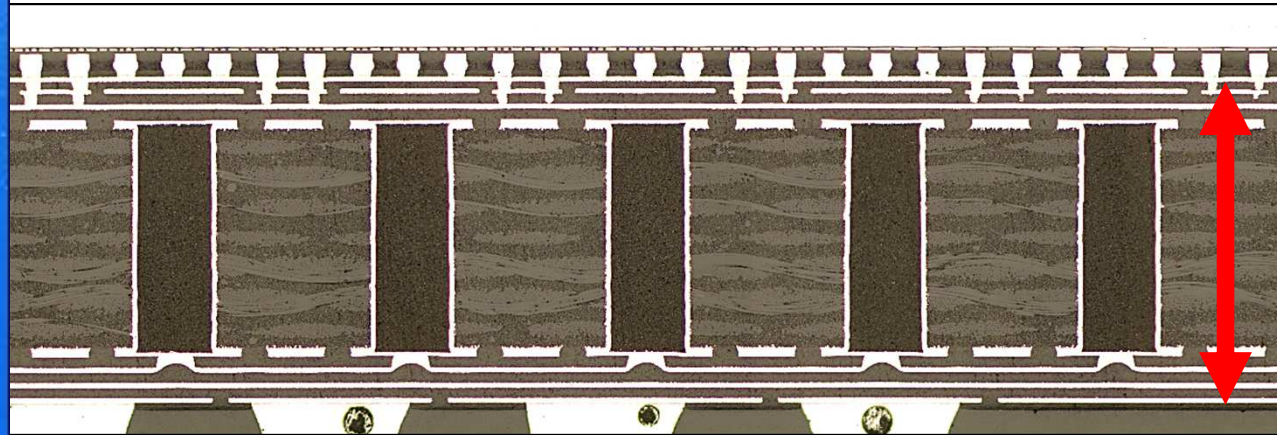


この距離が処理を遅くする



PKGの断面写真

PKG基板とCZ



1.1mm

(10円硬貨の厚みは1.5mm)

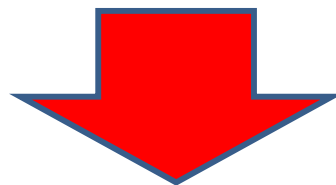
この**PKG**は10層基板
白い部分が銅配線、暗い部分が絶縁樹脂
銅の部分にCZが使われる
CZ処理することで銅表面が微細な凸凹形状となる
凸凹形状で銅と絶縁樹脂との密着性が大幅に上昇

PKGの進化

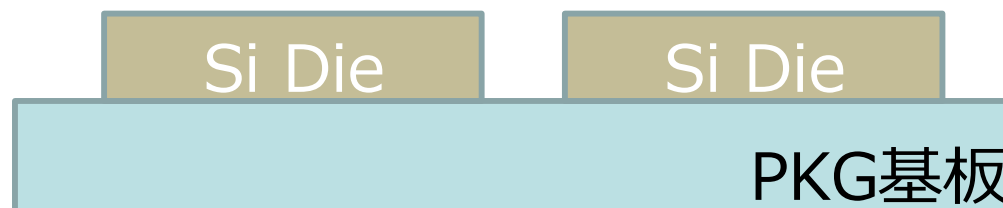
通常のPKG



一つのPKGに
一つの半導体



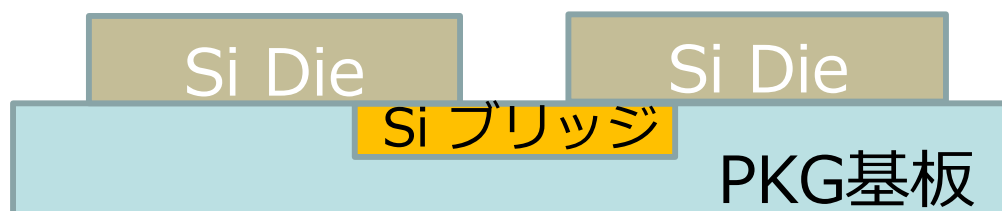
Chiplet



PKGを大きくして
複数個の半導体を搭載

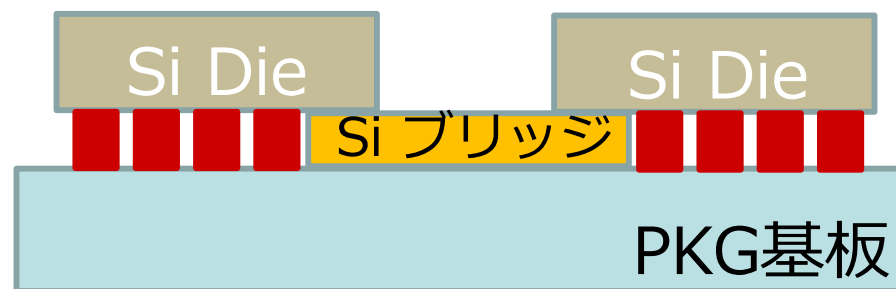
EMIB

(Embedded Multi-die Interconnect Bridge)



EFB

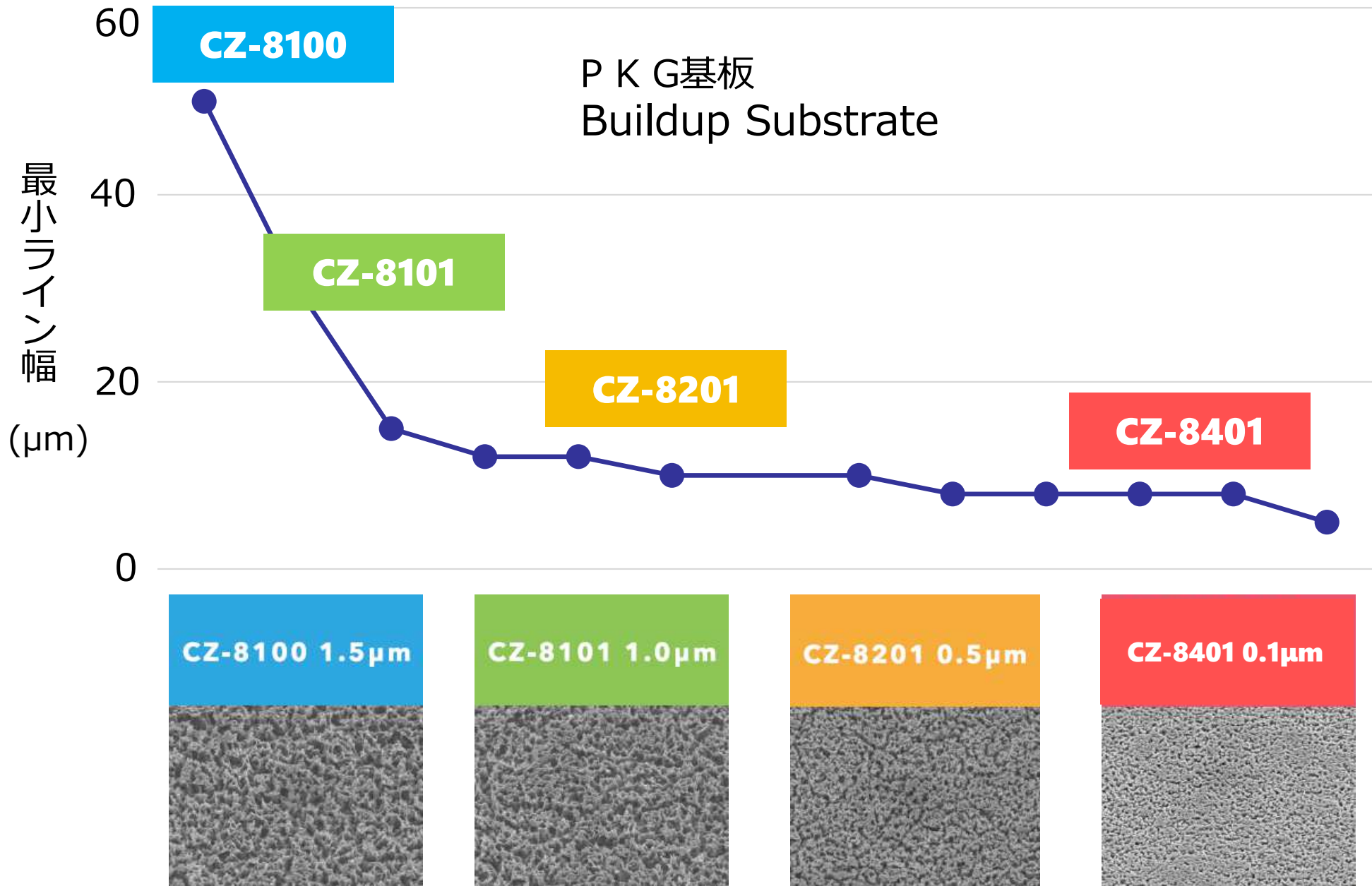
(Elevated Fanout Bridge)



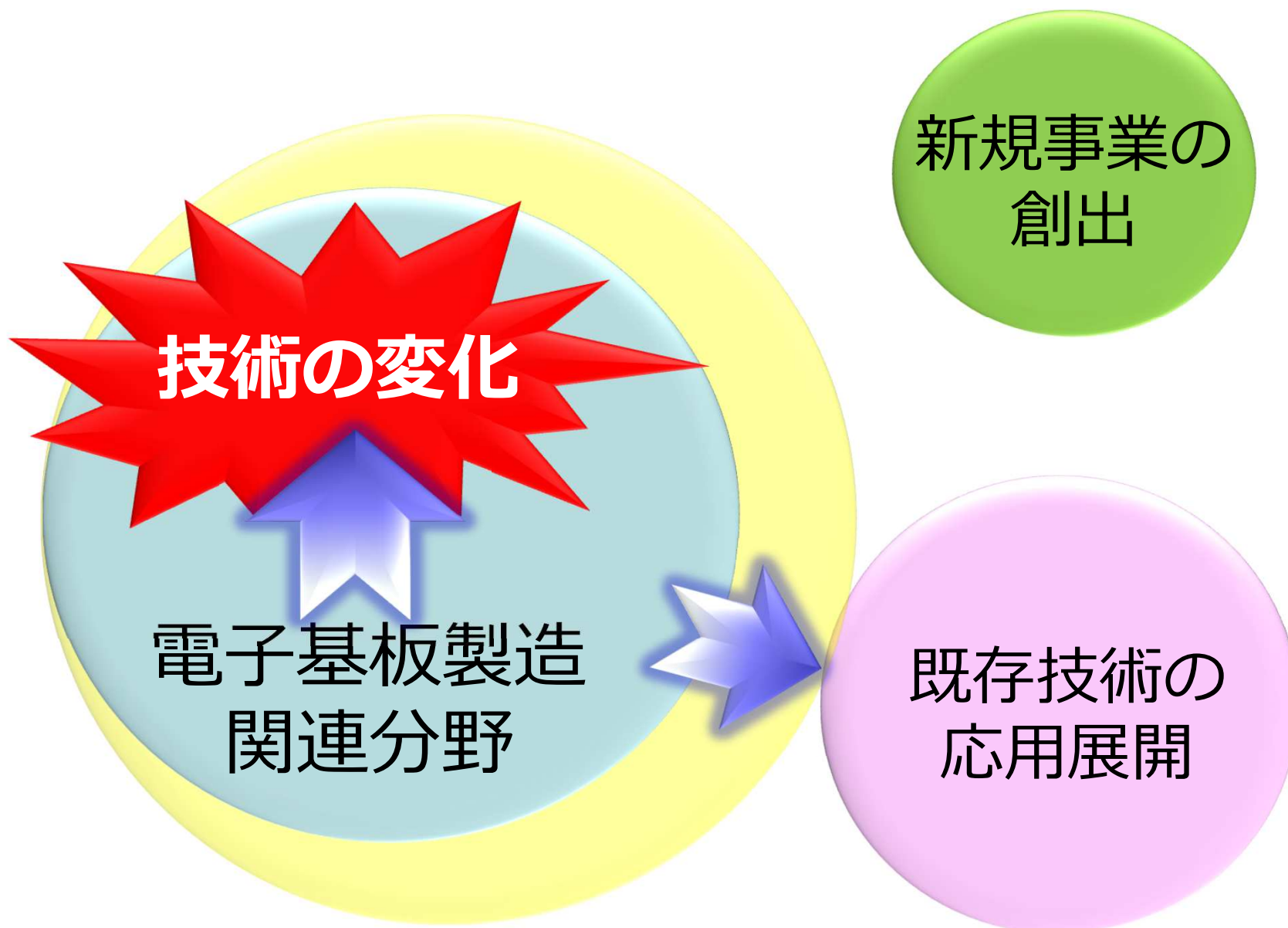
■ 銅ピラー

PKG基板サイズの大型化、層数の増加が見込まれる。

CZシリーズのロードマップ



事業領域の拡大を目指して



2030年ビジョン

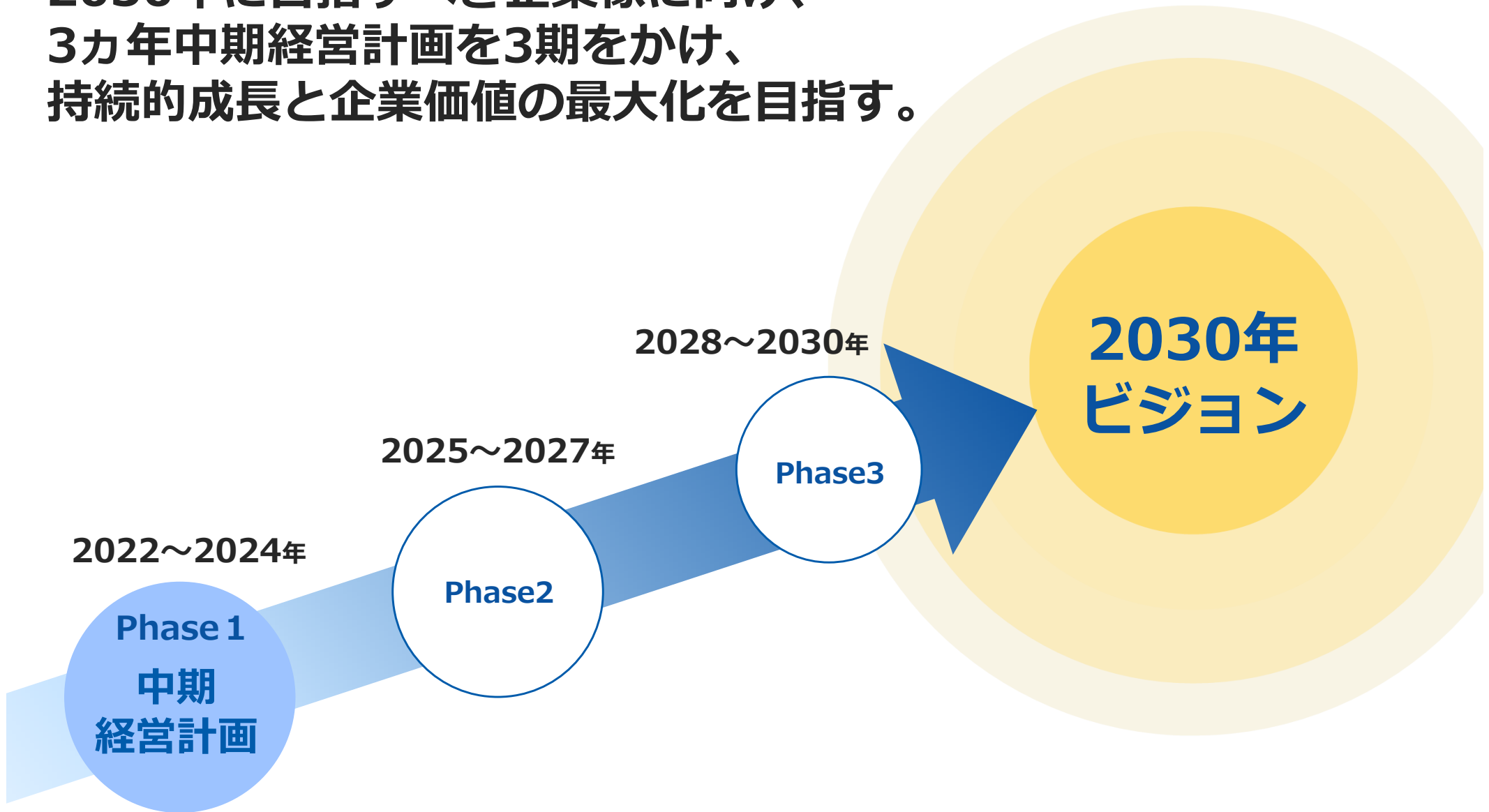
Phase 1

中期経営計画

(2022-2024)

2022年2月14日

2030年に目指すべき企業像に向け、
3カ年中期経営計画を3期をかけ、
持続的成長と企業価値の最大化を目指す。





**独創の技術で新たな価値を創造する
真のグローバルカンパニーになる**



研究開発型企业であり続ける



独創のAI企業としての顔をもつ

2024年数値目標（連結）

営業利益率

20%以上

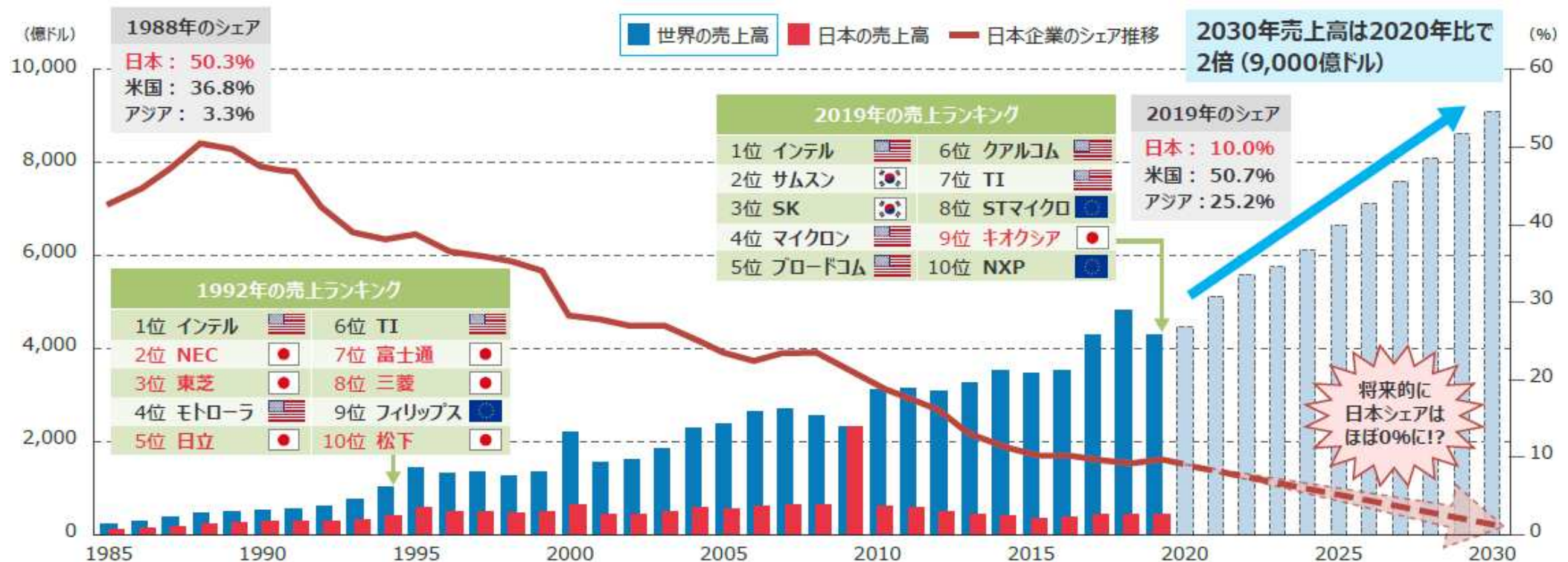
ROE

10%以上

DXの進展・脱炭素などの社会的動向を背景に

- データ量の増加・通信の高速化が促進される
- センシング・モニタリング・シュミレーティングなどが不可欠となる

➡ 半導体が飛躍的に増加することが当社の成長を牽引



出典：経済産業省『半導体戦略（概略）2021年6月p.60』

ご清聴ありがとうございました

このプレゼンテーション資料には、2023年3月25日現在の将来に関する予測が含まれております。記述している将来予測および業績予測は、当社が現時点で入手できる情報に基づき判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、様々な要因の変化により実際の業績は記述している将来見通しとは大きく異なる結果となる可能性があることをご承知ください。



<https://www.mec-co.com/>

